

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

关于 2026 年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为便于广大投资者更加全面深入了解产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度经营成果、财务状况，公司于 2026 年 10 月 13 日（星期二）上午 9:00—10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络文字互动形式召开了 2026 年半年度业绩说明会，与投资者就上述事项进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行了回答和说明。现将有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司已于 2026 年 9 月 29 日通过公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了临 2026-043 号《三佳科技关于召开 2026 年半年度业绩说明会的预告公告》。2026 年 10 月 13 日上午，公司董事长裴晓辉先生，副董事长、总经理昌望先生，财务总监汪兵先生，独立董事黄顺武先生，董事会秘书夏军先生出席了本次业绩说明会，针对公司 2026 年半年度经营成果、财务状况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就本次业绩说明会上投资者提出的问题给予了回答，现将本次业绩说明会提出的主要问题及回复情况整理如下：

1. 投资者提问：请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？

回复：公司未来盈利增长的核心驱动：一是半导体封装装备板块，依托国产替代、

先进封装产品研发及优质客户拓展，持续做大装备与模具业务；二是智能制造板块稳步拓展市场、挖掘增量订单。与此同时，公司持续优化客户结构、加大技术研发投入，巩固产品竞争力，通过供应链优化、生产协同等方式降本增效，提升整体盈利水平。

2. 投资者提问：请问贵司定增何时报上交所？进展情况如何？

回复：公司向特定对象发行 A 股股票相关工作正按计划稳步推进中，如有相关进展，公司会及时履行信息披露义务。

3. 投资者提问：贵司与长鑫属于同一控股股东，而且互为上下游，为何贵司一直不是长鑫的供应商？或者是否已成为长鑫的供应商？

回复：长鑫存储为我公司间接控股股东合肥产投集团重点投资孵化项目。公司将依托合肥产投集团产业链协同机制，积极拓展市场，面向市场需求，不断推动研发进度，按计划推进客户验证与产能匹配。公司及控股股东等各方将本着平等互利、优势互补、长期合作等原则，在产业发展、市场资源、金融支持及业务协同等方面形成全方位互动，共同致力将上市公司打造成为行业标杆企业。截至目前，我公司与长鑫存储无业务往来。

4. 投资者提问：请问贵司扇外型封装技术进展到什么地步了？有所突破吗？

回复：公司扇外型晶圆级封装设备相关研发工作正在持续推进中。该项目研发周期较长，存在不确定性。后续如有重大进展，达到信息披露要求，我公司将依规披露有关情况。

5. 投资者提问：请问合肥国资接手后，贵司有哪些变化？有何技术突破？

回复：合肥国资入主后，公司主要从以下几个方面推进工作：

（1）战略定位：将三佳科技打造为集团旗下控股型上市平台，聚焦战略性新兴产业布局，确立内生增长与外延并购相结合的发展战略；

（2）为落实发展战略，对公司业务架构和组织架构进行了调整优化，以支撑后续发展；

（3）产业整合落地：通过并购整合优质标的众合半导体，提升了上市公司经营规模，破除同行业无序内卷竞争，实现提质增效，夯实上市公司主业基本盘。收购众合半导体既是上市公司内生增长的重要举措，也为后续外延并购、投后整合积累实操经验，对未来并购整合具有指导意义；

（4）资本市场运作：一是再融资事项。公司有序推进 2026 年度向特定对象发行 A 股股票工作，目前内部审议已顺利完成，正准备向上交所申请受理并审核；二是股权激励事项。推动公司 2026 年限制性股票激励计划阶段性落地。

公司致力于用国产装备助力中国制造，创造价值、贡献社会。在半导体封装模具及设备领域深耕 40 余年，紧贴市场发展新趋势，研发新产品、新技术。公司技术研发实力较为深厚，是国产半导体封装模具及设备领域的重要供应商。

三、其他说明

关于本次业绩说明会的全部具体内容，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看。非常感谢各位投资者参加公司本次业绩说明会。在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出意见和建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

二〇二六年十月十四日